

半導体集積回路の回路配置の届出書

年 月 日

学術研究・産学官連携統括本部
知的財産統括室長 殿

<届出者> (個人番号は職員番号もしくは学生番号)

大学名		所属部局		
職名	氏名	個人番号		
TEL	()	E-mail		

東海国立大学機構発明等取扱規程に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

1. 半導体集積回路の回路配置の名称 (製品番号)

2. 半導体集積回路の構造 (該当する□をチェックしてください。)

- バイポーラ MOS Bi-MOS 光 IC
 その他 ()

3. 半導体集積回路の技術 (該当する□をチェックしてください。)

- TTL DTL ECL IIL CMOS NMOS
 PMOS その他 ()

4. 半導体集積回路の機能 (該当する□をチェックしてください。)

- ロジック メモリ マイクロコンピュータ リニア
 その他 ()

5. 半導体集積回路の回路配置の創作者の所属、職名、個人番号、氏名 (作成者が複数名いる場合は、ヒヤリング等の窓口となる代表者の氏名から順に記入し、併せて、持分の定めがある場合は、各自の持分 (合計 100%・整数) を記載してください。創作者に学生等を含む場合、その旨を明記してください。)

所属	職名	代表者氏名	個人番号	貢献	%
所属	職名	氏名	個人番号	貢献	%
所属	職名	氏名	個人番号	貢献	%

6. 半導体集積回路の回路配置の創作者の機構における業務内容 (当該回路配置との関係における機構での現在又は過去の業務内容を記載してください。)

7. 当該回路配置を用いた半導体集積回路（当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。）を
最初に譲渡，貸し渡し，譲渡及び貸し渡しのための展示，輸入等をした年月日

年 月 日

8. 登録手続の際には、半導体集積回路の回路配置を記載した図面及び譲渡書が必要となります。
また、半導体集積回路（現物）4個又は半導体集積回路を現した写真等が必要となります。届
出書受領後、連絡致しますので、ご協力ください。

本届出書は、パスワードを設定の上、以下の知財・技術移転担当部門代表アドレスまでご提出願いま
す。

岐阜大学：g_chizai@gifu-u.ac.jp

名古屋大学：chizai@aip.nagoya-u.ac.jp